



2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年1月30日

上場取引所 東

上場会社名 協栄産業株式会社

コード番号 6973 URL <https://www.kyoei.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 平澤 潤

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 (氏名) 村本 篤 TEL 03-4241-5511

四半期報告書提出予定日 2023年2月10日 配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第3四半期	45,673	9.0	1,325	56.5	1,442	53.7	840	△2.0
2022年3月期第3四半期	41,917	11.1	847	-	938	-	857	-

(注) 包括利益 2023年3月期第3四半期 849百万円 (△12.4%) 2022年3月期第3四半期 969百万円 (156.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第3四半期	279.72	-
2022年3月期第3四半期	281.62	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年3月期第3四半期	39,922	15,603	39.1
2022年3月期	36,347	14,964	41.2

(参考) 自己資本 2023年3月期第3四半期 15,603百万円 2022年3月期 14,964百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	-	30.00	-	30.00	60.00
2023年3月期	-	40.00	-	-	-
2023年3月期（予想）	-	-	-	30.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	60,000	5.3	1,600	15.4	1,600	15.8	900	△56.2	299.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社（社名）、除外 一社（社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

2023年3月期3Q	3,193,545株	2022年3月期	3,193,545株
2023年3月期3Q	187,553株	2022年3月期	187,098株
2023年3月期3Q	3,006,216株	2022年3月期3Q	3,046,668株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、資源価格上昇による部材の高騰や米国の政策金利の引き上げに起因した円安が続いた後、日米金利差の縮小により急速に円高が進むなど為替変動の影響を大きく受けました。また、入手難が続いている半導体デバイス部品は、メモリなどの一部製品では緩和の動きが見られましたが、パワー半導体などは依然として供給が逼迫しており、産業機械、自動車をはじめとする製造業は部品不足により生産活動が滞る事業環境が継続いたしました。

一方、設備投資は、先進物流施設などの建設投資、脱炭素に向けた環境対応投資が下支えとなったことにより、緩やかな持ち直しとなり、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

海外においては、中国では、新型コロナウイルス対応の行動制限の緩和により、感染者数が急増し、個人消費が低迷するなど、景気に下押し圧力がかかるとともに、ウクライナ情勢など地政学リスクが、資源価格の更なる上昇を招くなど、世界経済の先行きは極めて不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境は、デジタル化やネットワーク化が急速に進展することで、半導体デバイス品の需要は底堅いものがある一方、海外経済の減速を背景に半導体デバイス品やこれらを生産する機械装置の需要の調整圧力が一段と高まるなどが予想されるなど予断を許さない状態が続いております。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は456億7千3百万円、前年同期に比べて9.0%の増収、営業利益は13億2千5百万円、前年同期に比べて56.5%の増益、経常利益は14億4千2百万円、前年同期に比べて53.7%の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、繰延税金資産の取崩しを行ったことにより8億4千万円、前年同期に比べて2.0%の減益という成績になりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

(半導体デバイス事業)

- ・売上高 307億9千1百万円 (前年同期比14.4%増)
- ・営業利益 17億5千5百万円 (前年同期比44.6%増)

半導体デバイス事業においては、一部半導体デバイス部品において、製品確保が難しい状況のため、自動車や白物家電、工作機械や半導体製造装置関係をはじめとする製造業での生産制約が続いております。

このようななか、売上面は、部材供給において、逼迫した状況が続いておりますが、総体として徐々に解消する方向で進んだことと海外製メモリ等の伸長により、順調に推移いたしました。利益面は、売上面が順調であったため好調に推移いたしました。

事業の詳細は以下のとおりです。

半導体デバイスは、自動車関連では、危険運転対策用車載機器装置向けやその他装置向けの需要が底堅く推移し、堅調に推移いたしました。

白物家電関連は、部材不足のため、空調機の生産に制約が続いていることによりインバータ用パワー半導体の売上が、減少傾向で推移いたしました。

産業機関連は、半導体製造装置向け等でアナログ、パワー半導体は、製品確保が難しい状況が続いておりますが、受注は堅調に推移いたしました。

事務機器関連は、複合機向けの受注が伸長し、海外製メモリの売上が好調に推移いたしました。

スマートフォン関連は、納入先において他社品の受入れが停滞したことに伴い、当社納入デバイス品の受注が伸長し、好調に推移いたしました。

金属材料事業は、銅建値が高値圏で推移したことにより、売上増加の要因となり、順調に推移いたしました。

IC開発は、主力客先からの各種開発、テスト案件への増員要請に対し、パートナー会社活用により、好調に推移いたしました。IC試作サービスの受注に苦戦したことにより、全体としては堅調に推移いたしました。

(プリント配線板事業)

- ・売上高 50億9千5百万円 (前年同期比0.5%減)
- ・営業損失 4千1百万円 (前年同期営業損失8千7百万円)

プリント配線板事業においては、中国基板メーカーと連携して行っている海外基板ビジネスは、為替が足元で円高傾向に転じたため売上面、利益面とも堅調に推移いたしました。

自社製基板ビジネスは、販売単価の見直しなどで売上面は改善いたしました。生産面は、電力等の燃料、資材価格の高騰によるコスト増加並びに生産設備の不具合で国内工場の生産効率が低下したこともあり、営業損失となりました。

事業の詳細は以下のとおりです。

車載向け基板は、半導体不足による自動車メーカーでの生産調整及び採用デバイスの変更に伴う設計変更等もありましたが、メタルコア基板、厚銅箔基板、特殊技術を活用したLED応用製品向けモジュール基板の受注は堅調に推移いたしました。

民生向け薄板基板は、電子精密機器の一部機種では需要が回復いたしました。全体としては、低調に推移いたしました。

産業機向け基板は、各種ロボット制御向けや半導体製造装置向け基板の受注が好調に推移いたしました。

海外で中国基板メーカーと連携して行っている基板ビジネスは、新規製品の立上げ並びに電子玩具向けの受注が伸長したとともに為替が足元で円高傾向に転じたため、商談案件が増加傾向となり、堅調に推移いたしました。

(産業機器システム事業)

- ・売上高 67億8百万円 (前年同期比6.7%減)
- ・営業利益 5億2千3百万円 (前年同期比7.6%減)

産業機器システム事業においては、部材不足による納期長期化が続くなか、半導体市況の需要減少による設備投資への慎重さが見られるものの、機器製品、空調冷熱等の需要増により、総じて堅調に推移いたしました。

事業の詳細は以下のとおりです。

産業メカトロニクスは、主要客先からの加工装置・自動化システムの大型設備案件の需要に慎重さが見られましたが、堅調に推移いたしました。

FA機器は、製品構成部材の材料不足により製品確保が難しい状況が続いておりますが、半導体製造装置関連向けの需要伸長により、好調に推移いたしました。

施設向け設備は、空調冷熱では、北海道、東北地区からの受注が順調に推移いたしました。

3Dプリンタは、装置本体の受注に苦戦し、低調に推移いたしました。

制御装置は、物流市場におけるコスト増加等による設備投資抑制傾向もあり、物流倉庫向け搬送ロボット案件の受注に苦戦し、低調に推移いたしました。

(システム開発事業)

- ・売上高 27億6千8百万円 (前年同期比8.2%増)
- ・営業利益 2億1千1百万円 (前年同期比28.7%減)

システム開発事業においては、売上面は、電力関連向け受託開発やビジネス系ソリューションが順調に推移いたしました。利益面は人件費増加などもあり、やや低調に推移いたしました。

なお、システム開発事業では、9月及び3月に売上高及び利益の計上が集中する傾向にあります。これは従来からの業界傾向であります。

事業の詳細は以下のとおりです。

受託開発では、電力関連向けにおいては、新規案件、既存システム保守・改良案件により、順調に推移いたしました。また、鉄道関連向けをはじめとするその他向けも要員確保に苦戦しましたが、堅調に推移いたしました。

受注ソリューションでは、受注面は堅調に推移いたしました。

ビジネス系ソリューションでは、既存顧客からのリプレース案件もあり、売上面、利益面ともに好調に推移いたしました。

建設関連では、ソリューション案件は、大型案件の受注により、総じて順調に推移いたしました。また、パッケージ販売は、BIM対応の建築積算パッケージの販売が堅調に推移いたしました。

(その他)

- ・売上高 4億7千万円 (前年同期比34.1%増)
- ・営業利益 6千2百万円 (前年同期比228.9%増)

協栄マリンテクノロジ株式会社が行う、救命設備の販売・整備事業は、船舶用、航空機用救命具の整備受注が好調に推移するとともに、救命設備の販売も伸長し、好調に推移いたしました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて35億7千4百万円増加し、399億2千2百万円となりました。

- ・流動資産は、現金及び預金23億7千3百万円の増加、商品及び製品11億4千1百万円の増加等により、36億7百万円増加し、328億9千7百万円となりました。
- ・固定資産は、投資有価証券2億5千4百万円の減少、有形固定資産1億2千6百万円の増加等により、3千2百万円減少し、70億2千5百万円となりました。
- ・流動負債は、支払手形及び買掛金21億5千7百万円の増加、短期借入金11億9千2百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金10億2千6百万円の減少、未払法人税等6億5千1百万円の減少等により、17億7千7百万円増加し、192億6千1百万円となりました。
- ・固定負債は、長期借入金8億5千1百万円の増加等により、11億5千9百万円増加し、50億5千8百万円となりました。

この結果、純資産は、6億3千8百万円増加し、156億3百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の41.2%から2.1ポイント減少し、39.1%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、現時点では2022年10月28日に公表いたしました数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,518,737	4,892,203
受取手形及び売掛金	14,879,905	14,442,002
電子記録債権	2,757,207	2,916,529
商品及び製品	7,612,427	8,753,777
仕掛品	503,338	731,856
原材料及び貯蔵品	243,810	187,364
その他	781,303	975,889
貸倒引当金	△6,261	△1,900
流動資産合計	29,290,469	32,897,724
固定資産		
有形固定資産	1,376,667	1,502,992
無形固定資産	509,664	534,239
投資その他の資産		
投資有価証券	3,229,876	2,975,645
退職給付に係る資産	915,566	925,905
繰延税金資産	83	8,080
その他	1,377,553	1,446,577
貸倒引当金	△352,138	△368,423
投資その他の資産合計	5,170,940	4,987,784
固定資産合計	7,057,272	7,025,016
資産合計	36,347,742	39,922,740
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,574,522	10,731,639
電子記録債務	1,268,286	2,108,876
短期借入金	1,514,600	2,706,843
1年内返済予定の長期借入金	2,693,500	1,667,000
未払法人税等	697,044	45,621
賞与引当金	915,113	342,089
災害損失引当金	25,908	—
事業構造改善引当金	329,000	348,020
その他	1,466,116	1,311,307
流動負債合計	17,484,092	19,261,396
固定負債		
長期借入金	3,200,000	4,051,250
繰延税金負債	277,247	600,543
資産除去債務	—	121,537
その他	421,405	284,998
固定負債合計	3,898,653	5,058,329
負債合計	21,382,746	24,319,726

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,161,819	3,161,819
資本剰余金	3,120,110	3,120,023
利益剰余金	7,375,648	8,006,094
自己株式	△485,979	△486,541
株主資本合計	13,171,598	13,801,394
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,392,318	1,224,316
為替換算調整勘定	241,820	446,576
退職給付に係る調整累計額	159,258	130,725
その他の包括利益累計額合計	1,793,398	1,801,619
純資産合計	14,964,996	15,603,014
負債純資産合計	36,347,742	39,922,740

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
売上高	41,917,092	45,673,890
売上原価	36,233,489	39,412,448
売上総利益	5,683,602	6,261,442
販売費及び一般管理費	4,836,595	4,935,460
営業利益	847,006	1,325,981
営業外収益		
受取利息	379	64
受取配当金	73,059	85,546
為替差益	16,197	99,773
貸倒引当金戻入額	22,415	5,376
その他	94,049	86,536
営業外収益合計	206,101	277,298
営業外費用		
支払利息	60,344	62,441
シンジケートローン手数料	29,874	31,320
債権売却損	8,436	11,481
その他	15,668	55,154
営業外費用合計	114,324	160,398
経常利益	938,784	1,442,881
特別利益		
固定資産売却益	909	302
投資有価証券売却益	—	44,632
事業構造改善引当金戻入額	393	—
その他	17	24
特別利益合計	1,321	44,959
特別損失		
固定資産売却損	2,450	471
固定資産除却損	1,941	6,683
棚卸資産廃棄損	22,087	—
事業構造改善引当金繰入額	—	19,020
本社移転費用	148,996	129,257
特別損失合計	175,476	155,432
税金等調整前四半期純利益	764,628	1,332,408
法人税、住民税及び事業税	62,361	82,072
法人税等調整額	△155,721	409,451
法人税等合計	△93,359	491,524
四半期純利益	857,988	840,884
親会社株主に帰属する四半期純利益	857,988	840,884

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
四半期純利益	857,988	840,884
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	73,799	△168,002
為替換算調整勘定	69,315	204,756
退職給付に係る調整額	△31,368	△28,532
その他の包括利益合計	111,746	8,221
四半期包括利益	969,734	849,105
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	969,734	849,105

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(事業構造改善引当金)

2021年9月に閉鎖しました相模原事業所において、事業所用地引き渡しまでに発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を事業構造改善引当金として計上しております。

(新型コロナウイルス感染症の影響)

新型コロナウイルス感染症は、経済及び企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予見することは困難な状況にあります。当社グループでは、このような状況を踏まえ会計上の見積りを行っております。なお、現時点では当社グループの会計上の見積りに与える影響及び業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、当連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から、重要な変更はありません。

(グループ通算制度の適用)

当社及び国内連結子会社は従来連結納税制度を適用していましたが、前連結会計年度中にグループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより、当連結会計年度から単体納税制度に移行しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント					
	半導体 デバイス事業	プリント 配線板事業	産業機器 システム事業	システム 開発事業	その他	合計
売上高						
顧客との契約から生 じる収益	26,782,741	5,123,360	7,173,398	2,486,428	351,162	41,917,092
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	26,782,741	5,123,360	7,173,398	2,486,428	351,162	41,917,092
セグメント間の内部 売上高又は振替高	126,714	—	19,505	72,846	70	219,136
計	26,909,456	5,123,360	7,192,904	2,559,274	351,232	42,136,228
セグメント利益又は損 失(△)	1,214,017	△87,666	566,922	297,332	18,948	2,009,553

(注) 各報告セグメントに属する主な商品及び製品又はサービスの内訳は次のとおりです。

「半導体デバイス事業」は、半導体、電子デバイス、電子材料等の購入・販売、保守サービス及びIC設計を行っております。

「プリント配線板事業」は、プリント配線板の製造・購入・販売を行っております。

「産業機器システム事業」は、FA・環境システム設備等の購入・販売及び保守サービスを行っております。

「システム開発事業」は、ソフトウェア開発・システム開発及び情報システム機器・電子機器・パッケージソフト等の購入・販売及び保守サービスを行っております。

「その他」は、船舶用救命器具類の整備及び購入・販売を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の内容
(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	2,009,553
全社費用(注)	△1,162,546
四半期連結損益計算書の営業利益	847,006

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント					
	半導体 デバイス事業	プリント 配線板事業	産業機器 システム事業	システム 開発事業	その他	合計
売上高						
顧客との契約から生 じる収益	30,693,154	5,095,942	6,700,175	2,713,787	470,831	45,673,890
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	30,693,154	5,095,942	6,700,175	2,713,787	470,831	45,673,890
セグメント間の内部 売上高又は振替高	97,887	—	8,201	54,288	90	160,468
計	30,791,041	5,095,942	6,708,377	2,768,076	470,921	45,834,358
セグメント利益又は損 失(△)	1,755,913	△41,784	523,653	211,855	62,329	2,511,967

(注) 各報告セグメントに属する主な商品及び製品又はサービスの内訳は次のとおりです。

「半導体デバイス事業」は、半導体、電子デバイス、電子材料等の購入・販売、保守サービス及びIC設計を行っております。

「プリント配線板事業」は、プリント配線板の製造・購入・販売を行っております。

「産業機器システム事業」は、FA・環境システム設備等の購入・販売及び保守サービスを行っております。

「システム開発事業」は、ソフトウェア開発・システム開発及び情報システム機器・電子機器・パッケージソフト等の購入・販売及び保守サービスを行っております。

「その他」は、船舶用救命器具類の整備及び購入・販売を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	2,511,967
全社費用(注)	△1,185,985
四半期連結損益計算書の営業利益	1,325,981

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。